



2026年3月期 第1四半期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614

2025年8月8日

売上高は前年同期比で微増となるも利益は伴わず減益

- 当第1四半期の売上高は、製品開発事業で前年同期比減収となったが、電子システム事業及びマイクロエレクトロニクス事業では増収となり、全社ベースでも微増。
- 利益面は、前年同期比で製品開発事業の減収による減益影響や、電子システム事業で高い材料費率の商品売上構成となったこと、および前年1Qでは発生がなかった新基幹システムの償却費差分が発生したことから、営業利益・経常利益ともに赤字となるも、通期予想に対する進捗は1Qでの予想を上回る実績で推移。

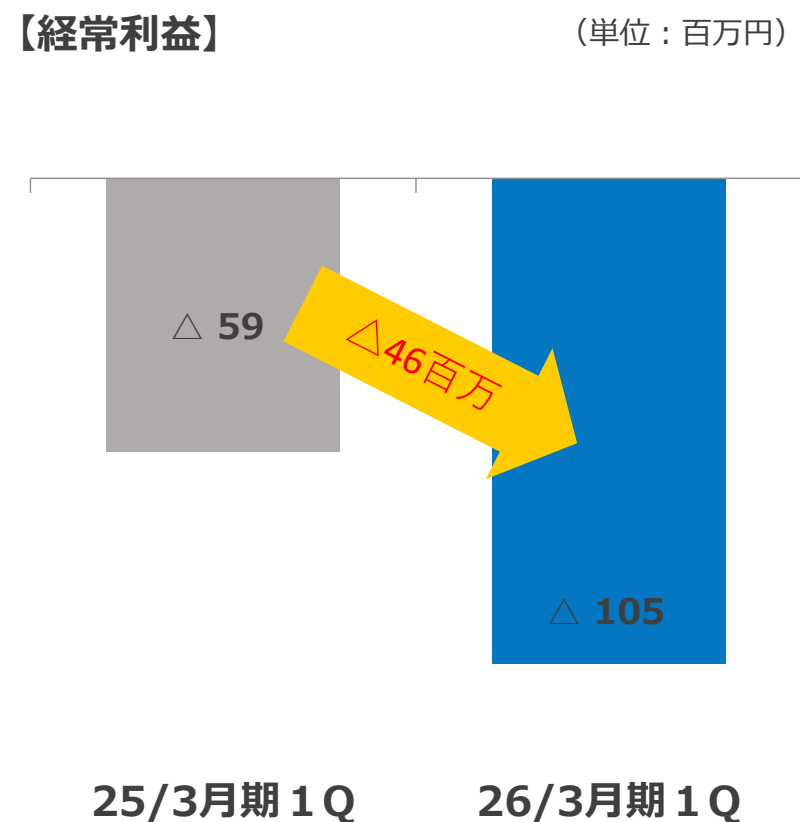
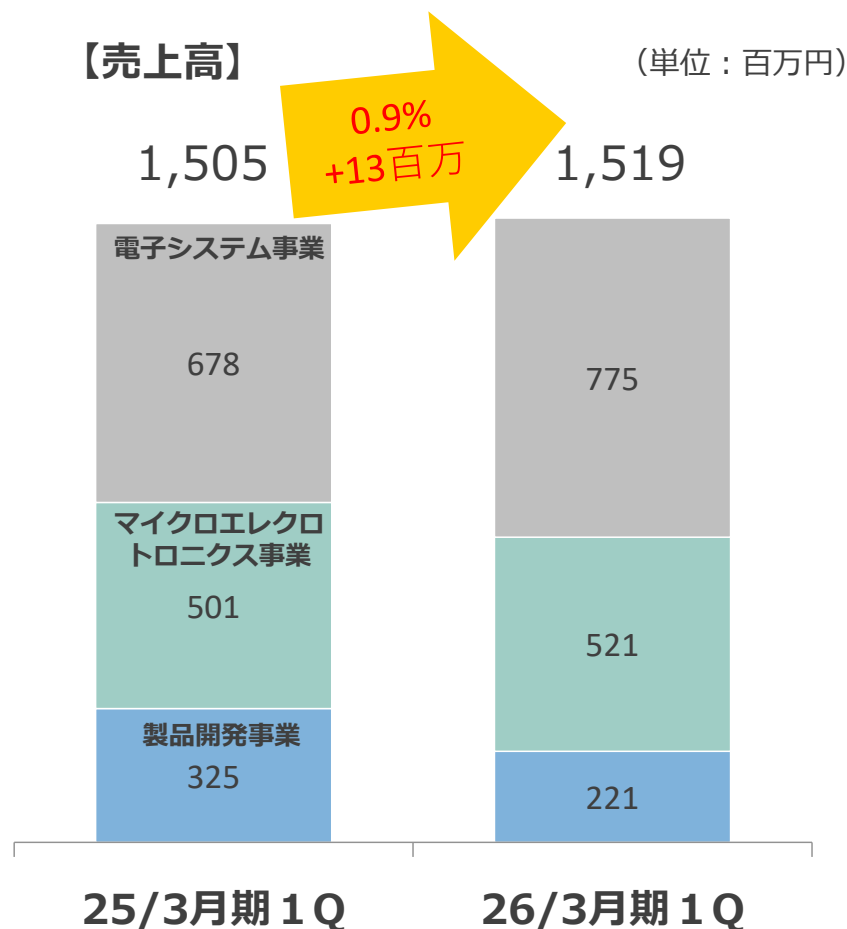
(単位：百万円、%)

	2026/3期 通期予想		2026/3期 1Q実績		計画比	前年同期比	
	金額	構成比	金額	構成比	進捗率	増減率	増減額
売上高	7,006	100.0	1,519	100.0	21.7	0.9	13
販管費	1,189	17.0	310	20.4	26.1	△3.3	△10
営業利益	136	1.9	△106	△7.0	—	—	△46
営業利益率	1.9		△7.0				
経常利益	130	1.9	△105	△7.0	—	—	△46
当期純利益	100	1.4	△75	△5.0	—	—	△34

電子システム事業は自動車市況の低迷により車載用専用計測機器の受注が減少するも、非車載計測機器の受注が増加し、前年同期比97百万円の増収。

マイクロエレクトロニクス事業は堅調に推移し、19百万円の増収。

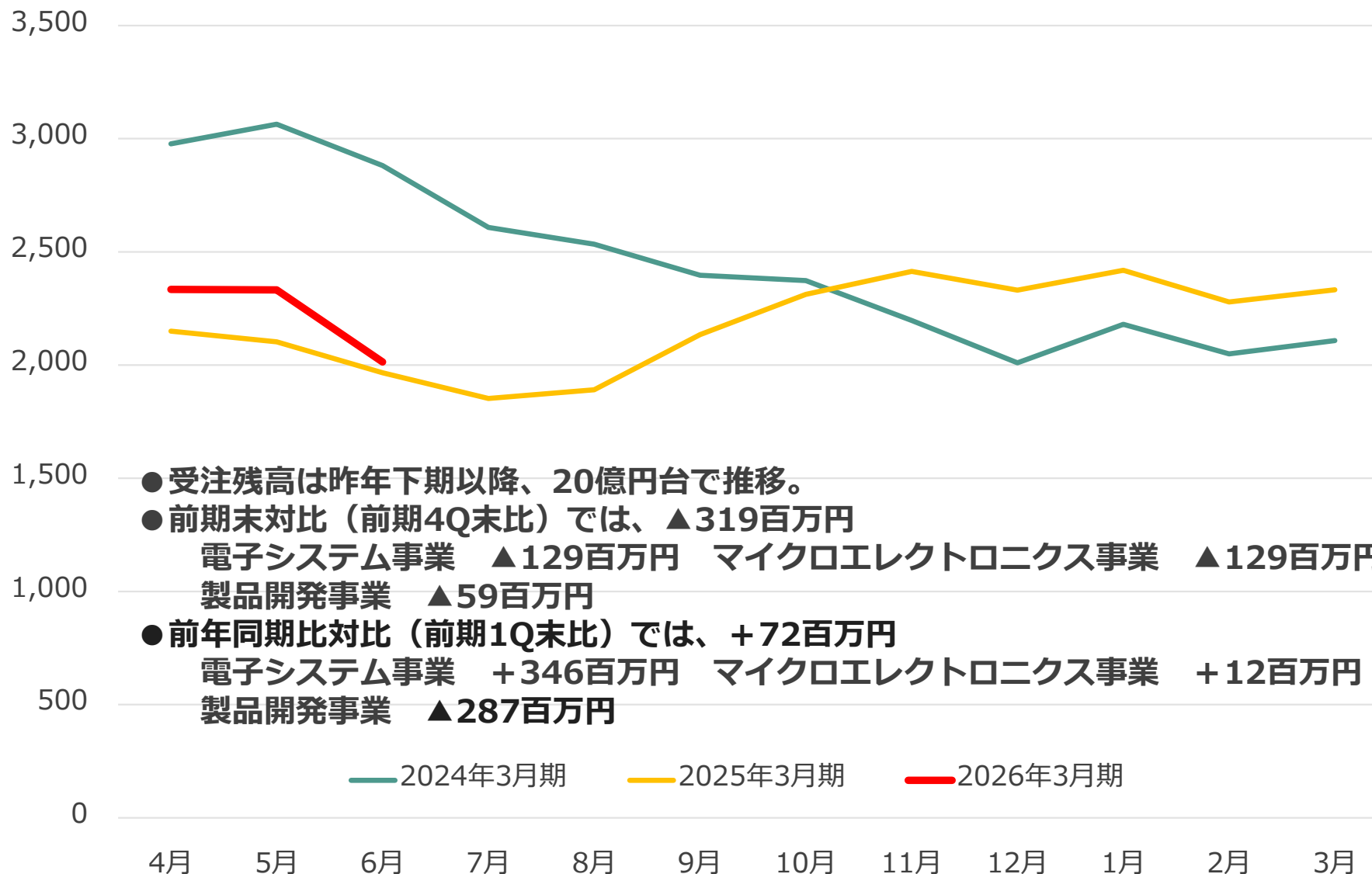
製品開発事業は国内ATMなど端末機器向けカメラの受注が減少し、前年同期比103百万円の減収。



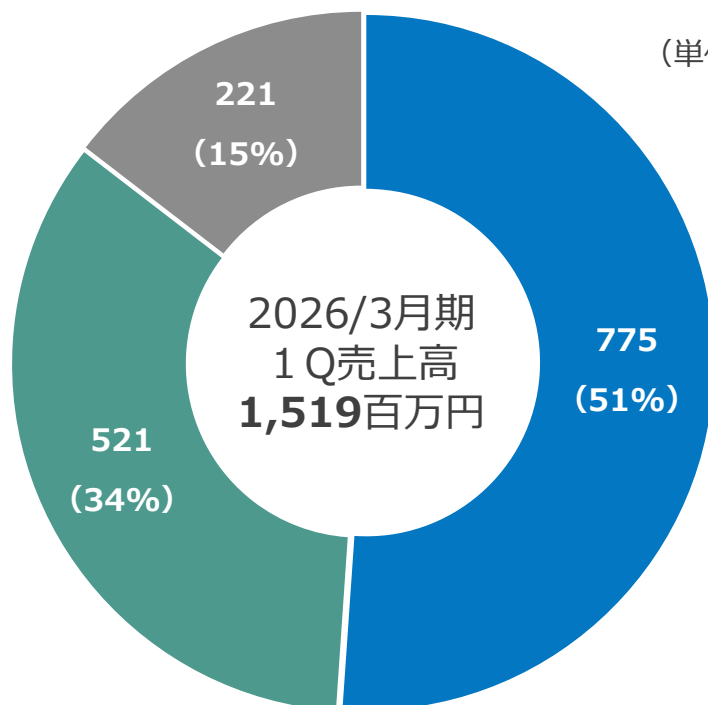
※前年同期比で売上は増収・経常利益は減益。

【受注残高（全社）】

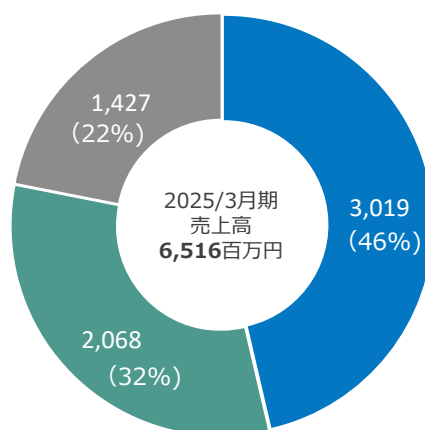
（単位：百万円）



(単位：百万円)



26/3月期1Q売上構成



(参考) 25/3月期売上構成

電子システム事業

半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

マイクロエレクトロニクス事業

LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

製品開発事業

製品開発事業

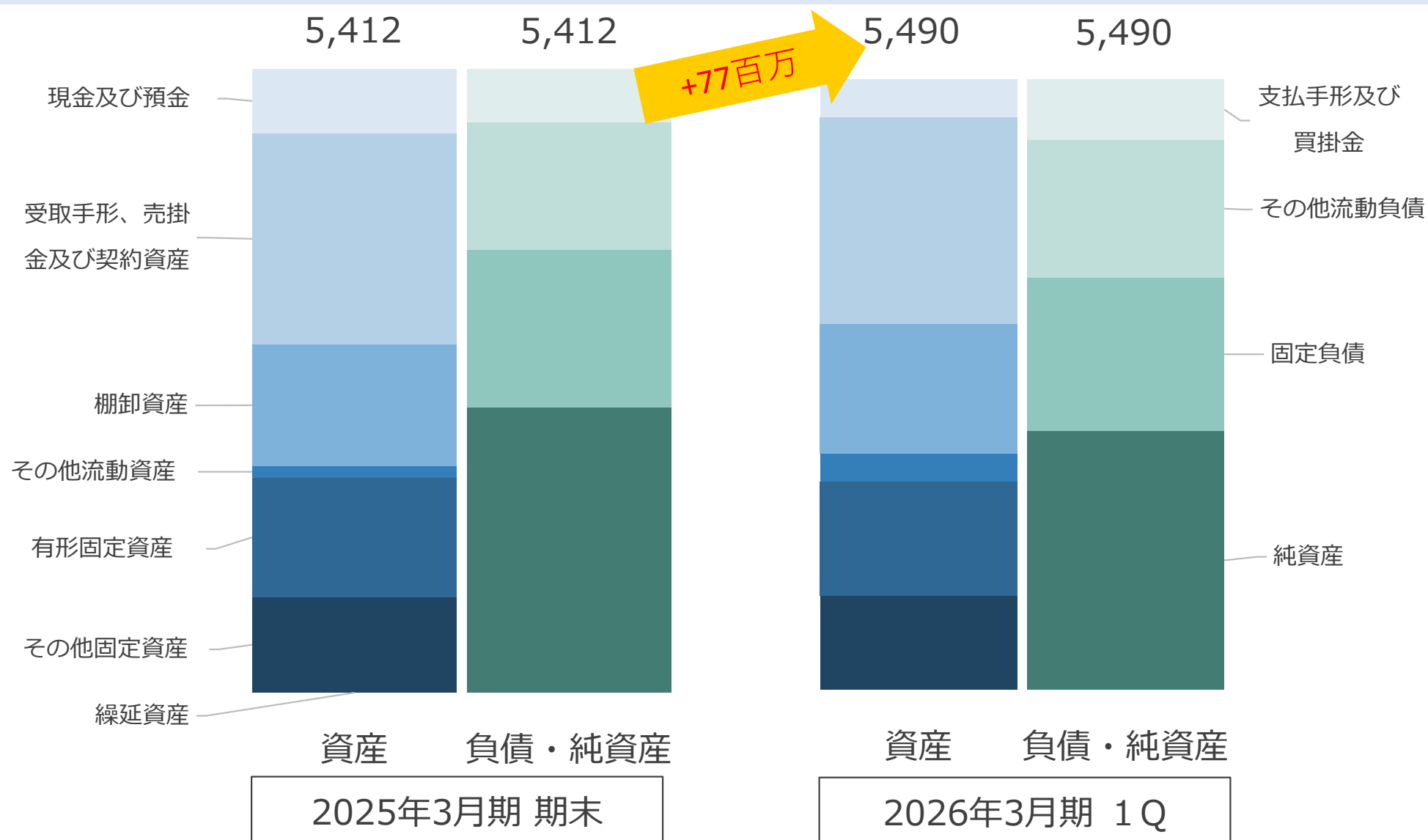
画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

貸借対照表

【流動資産】 部材の先行調達による棚卸資産が増加。

【流動負債】 仕入債務及び借入金が増加、賞与引当金が減少。

【純資産】 利益剰余金の減少により純資産減少。自己資本比率42.4% ▲3.3ポイント。



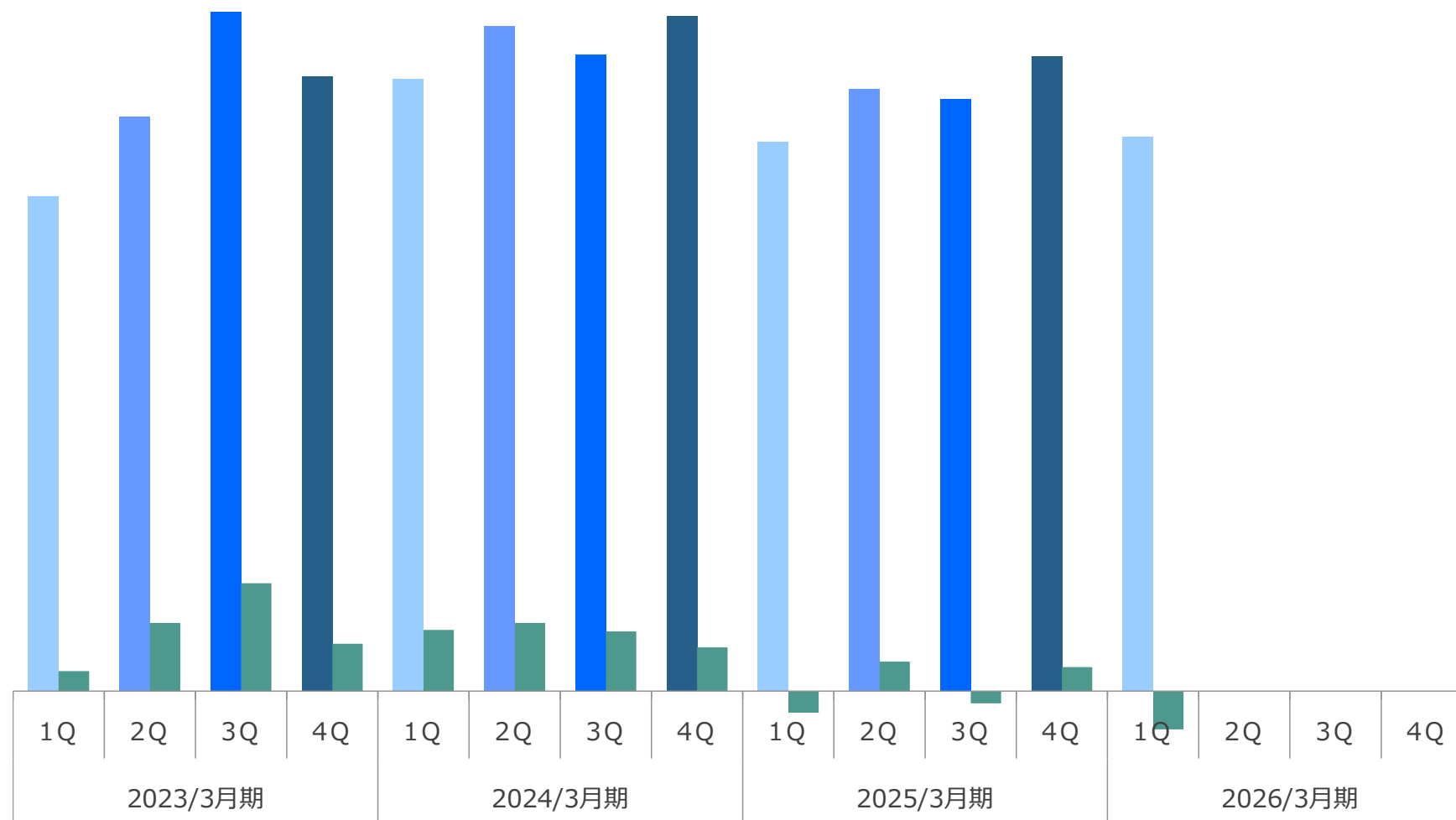
2025年

4月 18日	新製品 介護施設向けミリ波レーダー・カメラ一体型見守りシステム C-エイド ～2025年4月より注文受付開始～
4月 24日	台湾半導体市場への拡販に向け AGNEZ TECH INC.と協業開始
4月 28日	パナソニック ホールディングス株式会社とライセンス契約を締結し Nessum (IEEE1901-2020準拠) 通信モジュールを開発
5月 13日	決算発表 剰余金の配当に関するお知らせ
6月 2日	シキノハイテックとe-con Systemsが協業開始 組み込みビジョンソリューション のグローバル展開を拡大
6月 12日	決算説明会、中期経営計画
6月 24日	欧州商社 INELTEK社と取引基本契約を締結 ～欧州地域でのカメラ製品の拡販を強化～
6月 25日	第53期 定時株主総会 自己株式の取得に係る事項の決定に関するお知らせ 取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
7月 18日	自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ

1Q

2Q

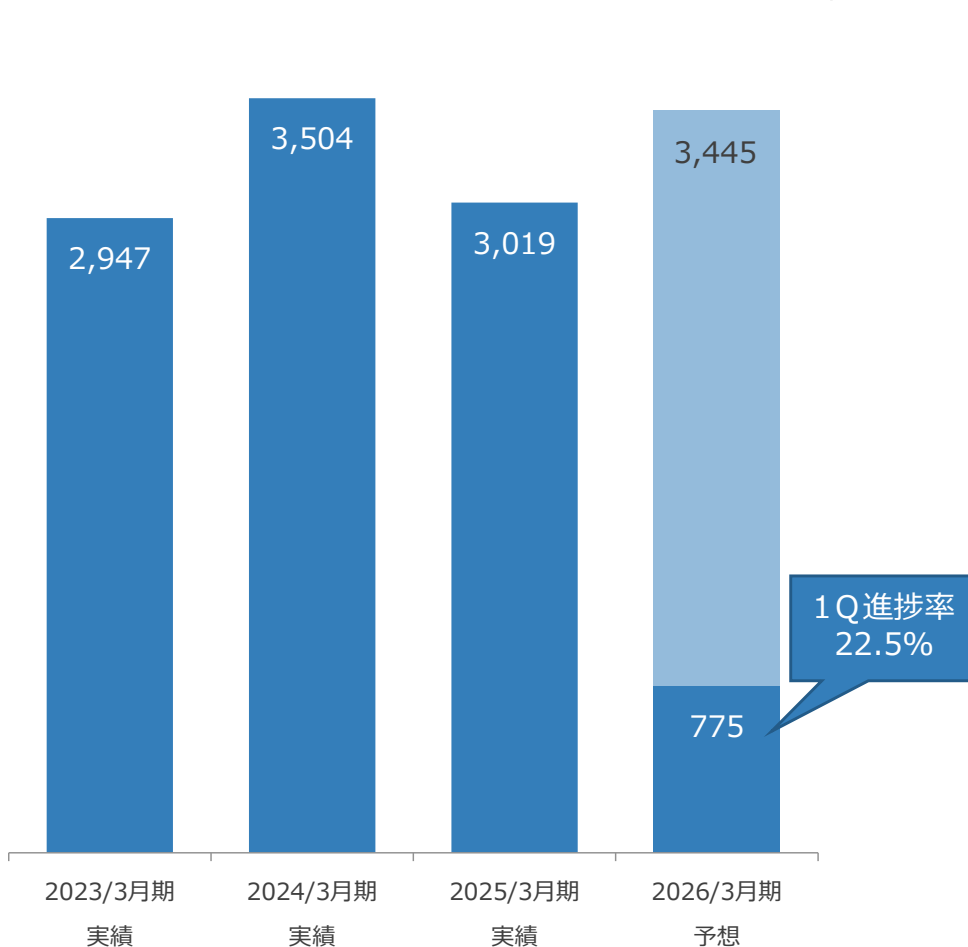
1Q売上高 2Q売上高 3Q売上高 4Q売上高
経常利益



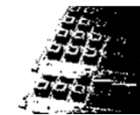
AIサーバー向けバーンインボードや半導体検査装置、非車載の産業用専用計測機器は前年同期比で売上増加。相互関税が影響し、各社設備投資で消極的な状態が継続していることから車載用専用計測機器が大きく減少。

【売上高】

（単位：百万円）

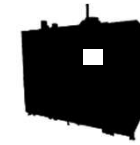


1Qトピックス



バーンインボード

前年同期比：165%



半導体検査装置 販売・リース

前年同期比：173%



車載製品用 専用計測機器 関連

前年同期比：46%



非車載製品用 専用計測機器 関連

前年同期比：603%

Nessum

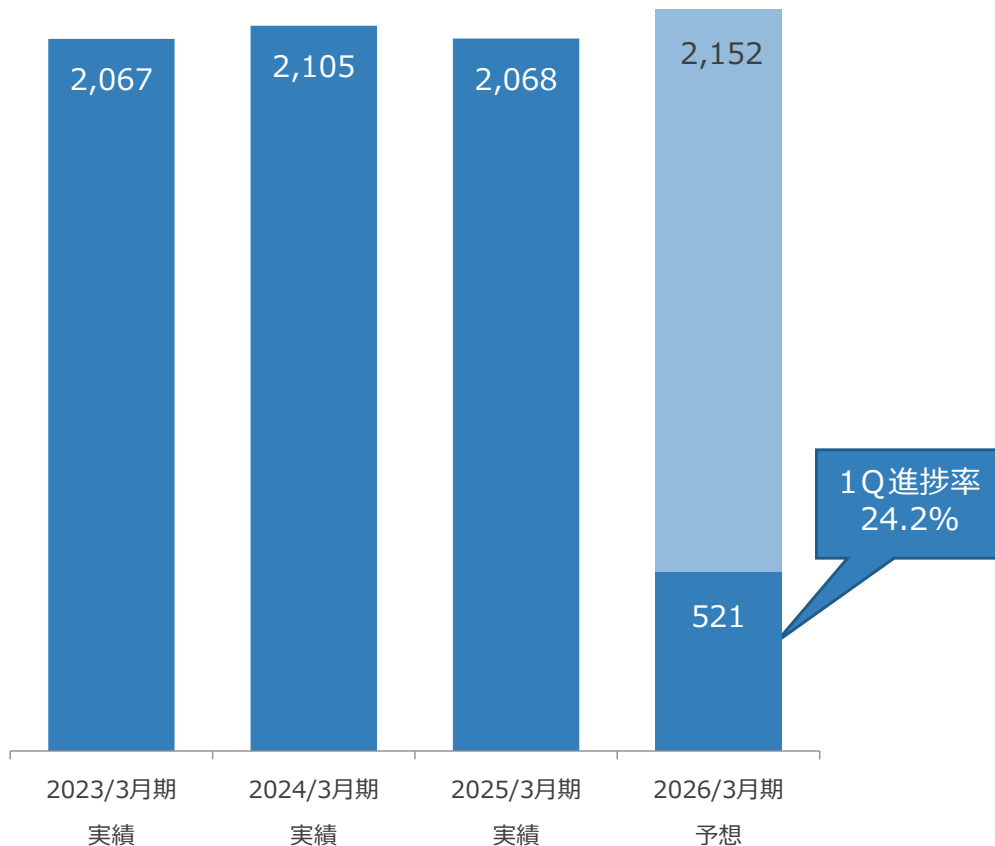
新型 4 Gアダプターで総務省北陸総合通信局の型式指定を取得（TELEC試験成績書取得）



アナログは自動車向けパワー半導体設計が増加。モバイル向けセンサー用半導体の受注も堅調。デジタルは自動車向け設計が減少も、次世代DSC向け新規開発を受注し前年より増加。海外比率においては、北米からのアナログ受託設計を新規受注し前年比で増加。

【売上高】

（単位：百万円）



1Qトピックス

➤ アナログ半導体設計受託

自動車向け等パワー半導体
前年同期比：138%

センサー用半導体
前年同期比：104%



➤ デジタル半導体設計受託

自動車関連デジタル設計
前年同期比：77%

DSC等画像処理関連
前年同期比：125%



➤ 海外取引率

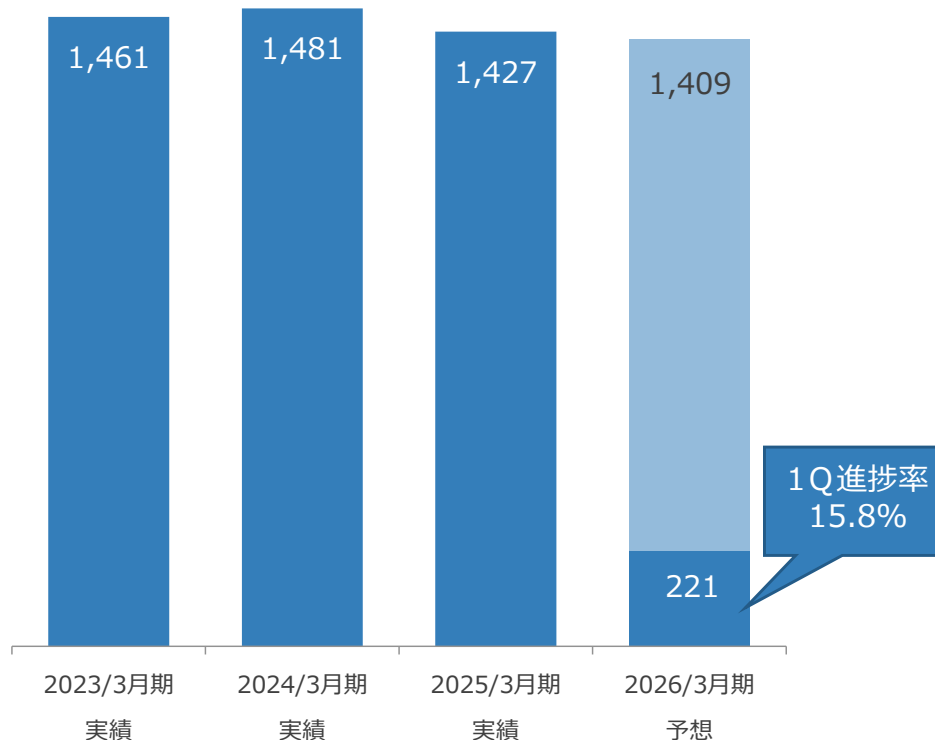
エンジニアリング&IP
前年同期比：193%



自動化/省人化ニーズの高まりから検査機器向け、産業用ドローン向けなど産業機器向けカメラは堅調。一部顧客の事業撤退に伴う国内ATMや新紙幣対応が一巡したセルフレジなど金銭機械を中心とした端末機器向けカメラは低調。

【売上高】

（単位：百万円）



1Qトピックス

- 産業機器向けは堅調、インフラ市場向けが減少

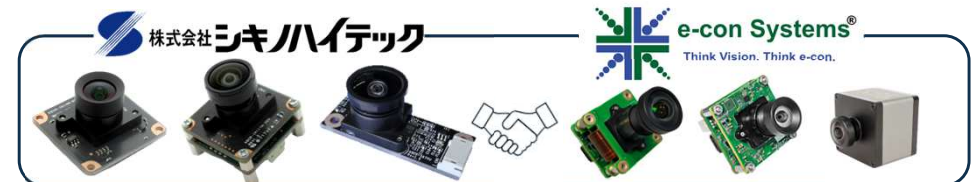


産業機器向け 検査機器他
前年同期比:115%

インフラ向け 端末機器他
前年同期比:43%

ソリューション

- e-con Systems社(印)と産業用カメラ、組込ビジョンソリューションでの協業を開始

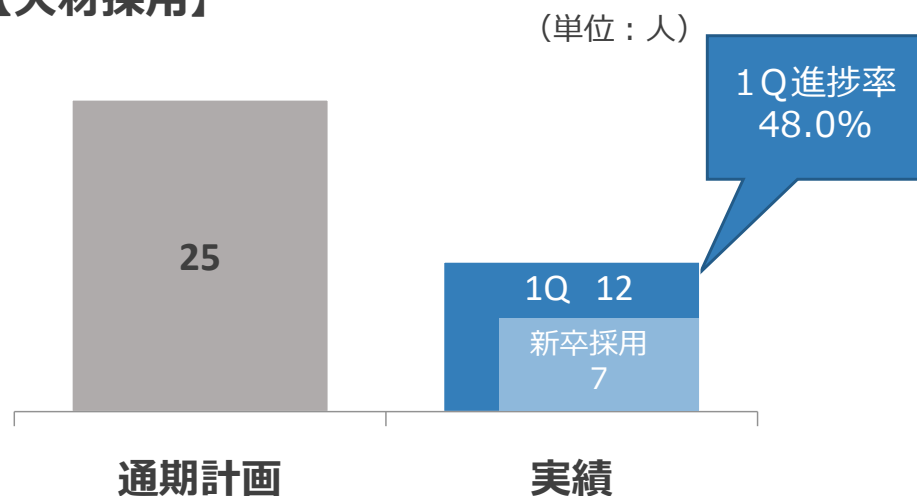


- ミリ波レーダー＋カメラ一体型見守りシステム「C-エイド」製品販売開始

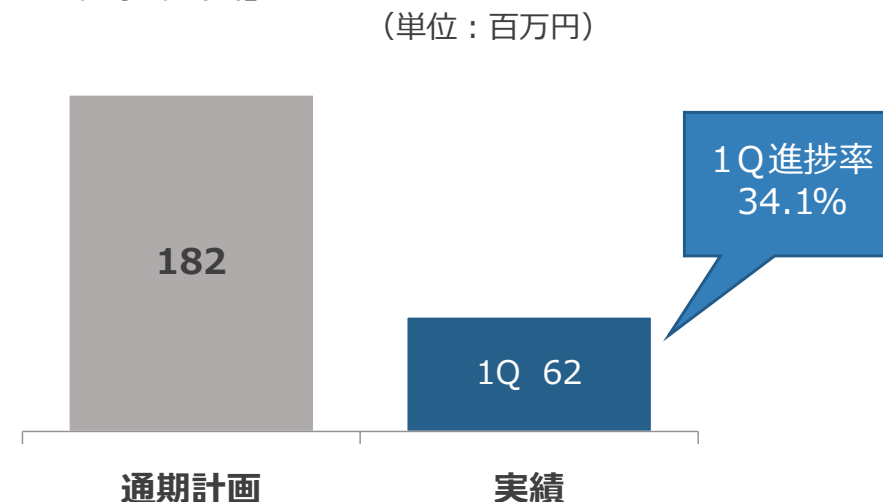


人材採用の進捗率としては順調なスタート、人材争奪戦の激化は継続。
研究開発費は開発効率化推進も前年度積み残しテーマで費用増となり全体では進捗が速い。

【人材採用】



【研究開発費】



主要開発テーマ

電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置
- ・次世代IoT-PLC通信モジュール

マイクロエレクトロニクス事業

- ・次世代JPEG IPコア・画像処理ボード

製品開発事業

- ・カメラモジュールラインナップ増強
- ・次世代エッジAIカメラシステム開発・介護向けシステム機能強化

本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

ご注意事項

数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役

執行役員管理本部長 舩田 敏彰

e-mail : IR-contact@shikino.co.jp

TEL : 0765-22-3477 FAX : 0765-22-3916

ホームページ : <https://www.shikino.co.jp/>